

IBM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIP NHIỀU NGĂN

Hãng I

Hãng IBM vừa công bố sẽ tạo nên chip siêu nhỏ có hiệu suất và năng lượng mạnh hơn với những thành phần được cấu tạo như những ngăn xếp trên đỉnh của mỗi chip. Công nghệ mới này sẽ làm giảm khoảng cách giữa các tín hiệu điện tử được truyền đi.

Chip mới gồm những lỗ siêu nhỏ trên mảnh silicon cực mảnh được trám bằng kim loại. Mỗi bộ phận của chip như bộ nhớ được sắp xếp trên phần đầu của chip.

Chip theo công nghệ mới của IBM

“Công nghệ này mở ra một lĩnh vực ứng dụng mới mà chúng tôi có thể làm được” -Lisa Su, người chịu trách nhiệm về nghiên cứu chất bán dẫn tại IBM cho biết.

IBM sẽ sử dụng phương pháp này để có thể tạo nên những chip có sức mạnh hơn cho các thiết bị không dây trong năm nay hoặc những năm tiếp theo.

Công nghệ này cho phép họ sử dụng tiết kiệm được 40% năng lượng so với những công nghệ trước đó. Su cho biết thêm: Đây là công nghệ mới nhất mà IBM đạt được. Chúng tôi đã nghiên cứu công nghệ này trong vòng 10 năm qua.

Thùy Linh

